



JASDAQ

2020年10月12日

各 位

シライ電子工業株式会社
代表取締役社長 大塚 昌彦
(コード番号：6658)

問い合わせ先： 取締役 財務・IR担当
福留 雅己

電話番号：075-861-8100

3次元立体配線用の透明フレキシブル銅張積層板 (FCCL) の開発について

当社は、FCCL (Flexible Copper Clad Laminate) 技術を用いて、3次元立体配線用の基材材料の開発に成功し、その材料を用いた3次元立体配線用透明フレキシブル基板及び透明ヒーターフィルムの販売を開始しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

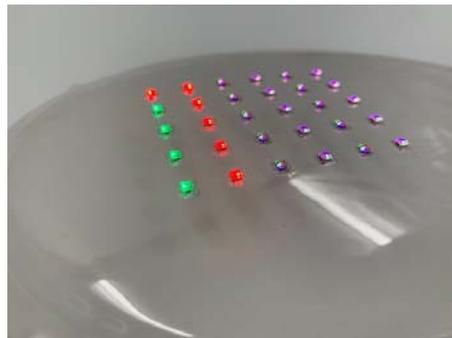


写真) 3次元立体配線用透明フレキシブル基板

銅張積層板を用いた3次元立体配線用透明フレキシブル基板及び透明ヒーターフィルムの特徴は、下記3点となります。

1. 賦形、インサート成型が可能で、プラスチック一体型の3次元立体配線構造
2. 全光線透過率90.0%の透明フレキシブル基板・ヒーターで、導体も分かりにくい透明構造
3. 高い耐熱性があり、部品実装後に賦形、成型することで3次元部品実装構造

3次元立体配線用透明フレキシブル基板及び透明ヒーターフィルムは、従来のSPETとSPCの2種の材料から販売を開始し、3次元立体配線構造や伸び率、プラスチックの素材などによって選択して使用して頂けるようにしました。

これまでのMID技術(Molded Interconnect Devices)やウェアラブル技術の収縮インキとは異なり、銅張積層板を用いた点は、業界としては初めてとなります。

この3次元立体配線用透明フレキシブル基板及び透明ヒーターフィルムは、2020年10月21日からポートメッセなごやで開催される第3回カーエレクトロニクス技術展で一般公開します。

なお、当該新商品の販売による当面の業績への影響は軽微であると考えておりますが、今後の販売状況により、業績に影響を及ぼすことがあった場合は速やかにお知らせいたします。

※当該新商品に関しましては、当社商品・市場開発部(077-502-0307)までお問い合わせ下さい。

以 上